

1. Спосіб ґрунтування паперового або картонного субстрату, який включає приведення субстрату в контакт з ґрунтовкою, що подається з джерела ґрунтовки, та осадження ґрунтовки на субстрат, який **відрізняється** тим, що включає електростатичне осадження за допомогою електроспінінга.
2. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що щонайменше частина ґрунтовки знаходиться у формі волокон, диспергованих в газовій фазі.
3. Спосіб за п. 1 або 2, який **відрізняється** тим, що волокна утворюються з розчину або емульсії ґрунтувального матеріалу в розчиннику або емульсійному середовищі.
4. Спосіб за п. 2, який **відрізняється** тим, що середній діаметр волокон становить від 0,05 до 1,0 мкм, переважно від 0,1 до 0,5 мкм.
5. Спосіб за п. 3, який **відрізняється** тим, що вміст ґрунтувального матеріалу в розчині становить від 5 до 50 мас. %, переважно від 20 до 45 мас. %.
6. Спосіб за п. 3, який **відрізняється** тим, що в'язкість розчину становить від 40 до 400 сПз, переважно від 50 до 200 сПз.
7. Спосіб за п. 3, який **відрізняється** тим, що розчинник вибраний з водних систем розчинників і, переважно, являє собою воду або суміш, яка містить воду і спирт.
8. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що ґрунтувальний матеріал вибраний з групи, яка складається з природних полімерів, поліспиртів, металоорганічних сполук і синтетичних полімерів.
9. Спосіб за п. 8, який **відрізняється** тим, що ґрунтувальний матеріал являє собою синтетичний полімер (гомо- або співполімер).
10. Спосіб за п. 9, який **відрізняється** тим, що синтетичний полімер є акриловим співполімером, переважно, емульгованим у водному емульсійному середовищі.
11. Спосіб за п. 10, який **відрізняється** тим, що вказаний акриловий полімер осаджують на субстрат до товщини 0,002-0,05 г/м², переважно 0,006-0,02 г/м², найбільш переважно близько 0,01 г/м².
12. Спосіб за п. 8, який **відрізняється** тим, що ґрунтовкою є діетаноламіноетан (ДЕАЕ).
13. Спосіб за п. 12, який **відрізняється** тим, що діетаноламіноетан (ДЕАЕ) осаджують на субстрат до товщини 0,02-0,5 г/м², переважно 0,06-0,2 г/м², найбільш переважно близько 0,1 г/м².
14. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що ґрунтовка містить домішку для модифікації морфології частинок ґрунтовки на субстраті.
15. Спосіб за п. 14, який **відрізняється** тим, що домішка являє собою розчинний полімер, переважно поліетиленоксидний полімер.
16. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що електростатична сила, виражена як напруга, що ділиться на відстань між субстратом і джерелом ґрунтовки, зведену в квадрат, становить від 0,02 до 4,0 В/мм², переважно від 0,2 до 0,5 В/мм².
17. Спосіб за п. 16, який **відрізняється** тим, що електростатична напруга становить від 10 до 50 кВ, переважно від 20 до 40 кВ, а відстань між джерелом ґрунтовки і субстратом становить від 100 до 1000 мм, переважно від 200 до 500 мм, найбільш переважно так, щоб електричне поле становило від 1 до 4 кВ/см.
18. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що заґрунтований субстрат піддають обробці в полум'ї або в коронному розряді перед нанесенням на нього покриваючої речовини.
19. Спосіб за п. 18, який **відрізняється** тим, що заґрунтований субстрат піддають обробці в коронному розряді перед нанесенням на нього покриваючої речовини.